

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2006 年 7 月 20 日 (20.07.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/075599 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/300186
- (22) 国際出願日: 2006 年 1 月 11 日 (11.01.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2005-005863 2005 年 1 月 13 日 (13.01.2005) JP
特願2005-066379 2005 年 3 月 9 日 (09.03.2005) JP
特願2005-096569 2005 年 3 月 29 日 (29.03.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE COMPANY, LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中村 敦 (NAKA-MURA, Atsushi) [JP/JP]; 〒3213231 栃木県宇都宮市清原工業団地 2 0ー7 住友ベークライト株式会社宇都宮工場内 Tochigi (JP).
- (74) 代理人: 岸本 達人, 外 (KISHIMOTO, Tatsuhito et al.); 〒1040031 東京都中央区京橋一丁目 1 6 番 1 0 号 オークビル京橋 4 階 東京セントラル特許事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: EPOXY RESIN COMPOSITION FOR SEMICONDUCTOR ENCAPSULATION AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体封止用エポキシ樹脂組成物及び半導体装置

(57) Abstract: Disclosed is an epoxy resin composition for semiconductor encapsulation essentially containing an epoxy resin, a phenol resin, a curing accelerator and an inorganic filler which is characterized in that a spherical molten silica having a pH of not less than 3 and not more than 5 as well as an eutectic material composed of silicon dioxide and titanium oxide or an eutectic material composed of silicon dioxide and alumina are contained as components of the inorganic filler. This epoxy resin composition is excellent in fluidity and moldability.

(57) 要約: エポキシ樹脂、フェノール樹脂、硬化促進剤、及び無機充填材を必須成分として含むエポキシ樹脂組成物において、前記無機充填材の成分として pH が 3 以上 5 以下の球状溶融シリカ、二酸化珪素と酸化チタンとからなる共融物、又は二酸化珪素とアルミナとからなる共融物を含む流動性、成形性に優れた半導体封止用エポキシ樹脂組成物が提供される。